FOR IMMEDIATE RELEASE

# SMART Modular世邁科技推出全新BGAE440工業嵌入式eMMC

## *提供穩健儲存功能 滿足工業應用需求*

***台北，2020年12月16日 -*** 全球專業記憶體與儲存解決方案的領導品牌SMART Modular[世邁科技](https://www.smartm.com/index.asp)（NASDAQ: SGH）宣佈推出DuraFlash™ eMMC（embedded MultiMediaCard；eMMC）產品線最新[BGAE440](https://www.smartm.com/product/499" \t "_blank)系列。DuraFlash™為SMART Modular世邁科技旗下快閃記憶體解決方案品牌，專為工業嵌入式應用市場提供更高標準的耐用性及信賴性。  
  
DuraFlash™ BGAE440系列符合JEDEC eMMC v5.1規範，並提供標準BGA封裝153-ball，尺寸11.5mm x 13mm以及100-ball，尺寸14mm x 18mm兩種規格，能確保在極高低或變化大的溫度範圍、劇烈震動、高濕度、鹽霧、沙塵，以及曝露於二氧化硫等嚴苛環境中仍維持正常運作。  
  
SMART Modular世邁科技Specialty Memory資深副總裁Alan Marten表示：「這些解決方案相當適用於需要嵌入式記憶體及儲存裝置的應用。DuraFlash™ BGAE440 eMMC創造出無與倫比的效能，可滿足工程師對整合記憶體至IIoT裝罝的設計需求。同時，DuraFlash品牌更體現SMART Modular世邁科技的承諾，為工業嵌入市場提供最高品質、耐用及高可靠的快閃記憶體。」  
  
SMART Modular世邁科技BGAE440 eMMC同時滿足嵌入式系統中直焊式快閃儲存的需求，不同於一般eMMC適用行動電話或平板等消費性應用，BGAE440 eMMC特別針對工業嵌入式運算應用所打造，可用於航太、管線檢測裝置、行動基地台、安全監控裝置、醫療診斷裝置等市場應用。

### 技術規格

SMART Modular 世邁科技BGAE440 eMMC特色包含：

* 採用最新快閃記憶體主控晶片及3D NAND技術
* 符合JEDEC標準下eMMC v5.1規範，提供153-ball與100-ball標準BGA封裝
* 可運作於工業溫度區間（-40°C to 85°C）及JEDEC標準溫度範圍（25°C to 85°C）
* 適合有封閉型BOM（locked BOM）的工業嵌入式應用
* 提供32GB至256GB容量

欲了解BGAE440 eMMC詳細產品規格，請參考[官網產品介紹](https://www.smartm.com/product/499)。若需要完整的產品系列資訊，請上[www.smartm.com](http://www.smartm.com/)或與[SMART Modular世邁科技團隊聯繫](https://www.smartm.com/support/contact-us/sales-request)。

### 關於SMART Modular世邁科技

全球專業記憶體與儲存解決方案的領導者SMART Modular世邁科技於美國加州成立超過三十年，為美國那斯達克掛牌上市公司 (NASDAQ: SGH)，致力於開發中高階工業及企業級嵌入式記憶體產品，包含DRAM記憶體模組、SSD固態硬碟、混合式解決方案等，除了標準化與強固型規格外，更針對不同產業應用提供客製化服務，跨足電腦、網通、電信、儲存設備、移動裝置、軍事、航空及工業應用等。SMART Modular世邁科技提供高度客製化的產品設計能力、嚴謹可靠的測試服務與即時專業的技術支援，並與全球領導OEM客戶緊密合作，從產品設計到上市，均能提供高效可靠的解決方案，滿足各類工控產業的需求。更多資訊請參考: <http://www.smartm.com>